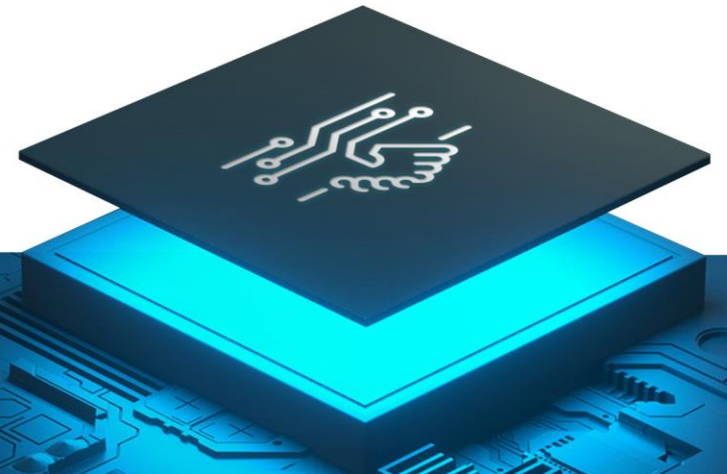


반도체소부장 혁신융합대학

첨단 반도체 융합트랙 & 마이크로디그리 소개자료

총괄책임자
사업단 명

성균관대학교 이강윤 교수
반도체소부장 혁신융합대학사업단



○ 첨단 반도체 융합트랙

- ▷ 이수학점: 18학점
- ▷ 융합트랙 이수증 수여

첨단 반도체 융합트랙 로드맵

기초소양	초급	중급	고급
반도체공학세미나	기초회로이론 (회로이론1)	아날로그디지털 집적회로설계 (아날로그디지털 혼성집적회로설계)	현장실습1 (현장실습1)
반도체기술과산업	기초논리회로 (논리회로)	기계학습개론 (기계학습개론)	정보통신현장실습2 (정보통신현장실습2)
반도체기초수학 (공학수학1/기초공학수학1)	기초물리전자 (물리전자)	지능형시스템설계 (지능형시스템 집적회로설계)	정보통신현장실습3 (정보통신현장실습3)
기초확률및통계 (확률및통계)	기초반도체공학 (반도체공학)	자료구조및알고리즘 (자료구조및알고리즘)	
	기초제어공학 (제어공학기초)	반도체전자소재 (반도체전자재료)	
	기초신호및시스템 (신호및시스템)	반도체소자설계 (반도체소자설계)	
		첨단반도체패키징 (반도체패키징)	

○ 첨단 반도체 마이크로 디그리(MD)

- ▷ 이수학점: 9 학점
- ▷ BMD, IMD, AMD 수여
(장학금, 이수증 지급)

구 분	수강 과목	이수학점
BMD	반도체공학세미나, 반도체기술과 산업, 기초반도체공학 중 택1 + 기초/초급중 2개	9 학점 (초급 1과목 필수)
IMD	중급 1과목(필수) + 초급/중급중 2과목	9 학점
AMD	고급 1과목(필수) + 중급/고급중 2과목	9 학점

첨단 반도체 마이크로디그리 로드맵

기초소양	초급	중급	고급
반도체공학세미나	기초회로이론 (회로이론1)	아날로그디지털 집적회로설계 (아날로그디지털 혼성집적회로설계)	현장실습1 (현장실습1)
반도체기술과산업	기초논리회로 (논리회로)	기계학습개론 (기계학습개론)	정보통신현장실습2 (정보통신현장실습2)
반도체기초수학 (공학수학1/기초공학수학1)	기초물리전자 (물리전자)	지능형시스템설계 (지능형시스템 집적회로설계)	정보통신현장실습3 (정보통신현장실습3)
기초확률및통계 (확률및통계)	기초반도체공학 (반도체공학)	자료구조및알고리즘 (자료구조및알고리즘)	
	기초제어공학 (제어공학기초)	반도체전자소재 (반도체전자재료)	
	기초신호및시스템 (신호및시스템)	반도체소자설계 (반도체소자설계)	
		첨단반도체패키징 (반도체패키징)	

구 분	과 목
신설과목 (2023-겨울계절)	반도체공학세미나 반도체기술과산업
기존과목(C/L)	나머지 과목들

◆ 교과목 구분: 사업단교과목명 (실제 개설교과목명)

「첨단 반도체 마이크로디그리」
신청 접수

* 1차 신청 기간: 12월 6일(수)까지

* 신청폼:



문의처:

www.cosssemi.kr

(T: 031-290-7991)

지원혜택

- Q1 사업단 기준에 맞는 우수학생 선발 및 장학금 지급
- Q2 반도체 소·부·장 관련 장비 및 FAB 활용 등의 실습 기회 제공
- Q3 산업체 전문가 멘토링 및 전문가 초빙 세미나 진행
- Q4 산업 밀착형 WE-MEET 과목을 통한 현장실습 기회 제공
- Q5 반도체 소·부·장 특화 교육 프로그램 제공
- Q6 융합트랙 및 마이크로디그리 수여

